

# Stealth Dicing für MEMS und MOEMS

Kategorien	Copyright?	Bezugsjahr:	Geographischer Bezug:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mikroelektronik Produktion</li> <li>▪ <span style="color: green;">Einsparung von Chemikalien</span></li> </ul>	Ja	2025	Deutschland

## Technologiebeschreibung:

Für die klassische sägebasierte Vereinzelung von MEMS und MOEMS Wafern wurden bisher Schutzlack (z.B. AR-PC5000) und signifikante Mengen von Lösemitteln (Isopropanol, Aceton) benötigt. Stealth Dicing ermöglicht die Lack- und Lösungsmittelfreie Vereinzelung von MEMS und MOEMS Wafern.

## Bezugsgröße:

24 Wafer (Ein Batch zur Fertigung von 200 mm Wafern)

## Copyright:

Fraunhofer IPMS - Dieser Datensatz ist im öffentlich geförderten Projekt Green ICT @ FMD entstanden und ist zu 100% vom BMBF gefördert. [mehr Informationen](#)

## Systemgrenzen:

Prozessbilanz

## Datenqualität, -herkunft:

Die Prozessdaten wurden am Fraunhofer IPMS im Kontext einer Forschungsumgebung gewonnen.

## Datenübersicht:

### Einsparung

	Wert	Einheit
Einsparung von Chemikalien	100	%
Mit dem sägebasierten Vereinzelungsprozess wurden je 2×12 Liter Aceton und IPA für die Bearbeitung eines Loses benötigt. Mit dem Stealth Dicing basierten Prozessen entfällt der Bedarf zu 100%.		